

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-004

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 620,507,403 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

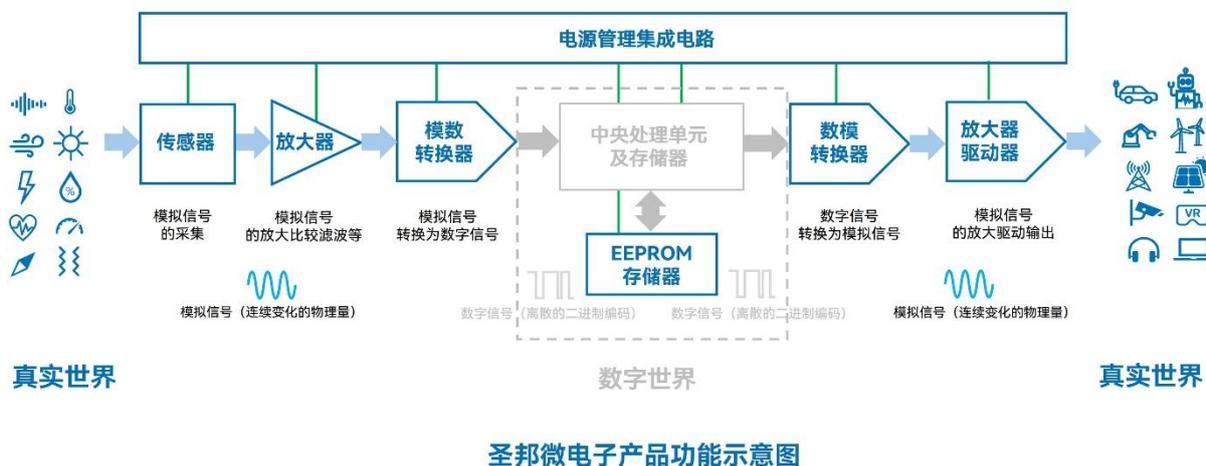
2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研发与销售的高新技术企业，提供品类广泛、差异化的通用型和特定应用优化模拟集成电路产品组合，包括模拟信号和混合信号产品，涵盖了信号链、电源管理以及传感器等领域。其中信号链和电源管理这两大类模拟集成电路产品是公司产品矩阵的双支柱，奠定了公司在综合模拟集成电路行业的领导地位。公司的信号链集成电路能够以极高的保真度对真实世界的各类信号进行电子化采集、调理、放大及数据转换，确保了从

采集到输出的端到端数据完整性，满足高精度、低噪声、低失真的精密驱动型应用需求。公司的电源管理集成电路是系统能源架构的核心组件，负责电子系统内功率流的调节、转换、分配与保护，在保障系统稳定可靠运行的同时，实现最佳能效。作为对模拟产品组合的补充，公司还提供一系列专业的传感器产品，传感器作为真实世界与数字世界的连接入口，可实现对关键环境和物理参数的高精度测量与监测。

下图展示电子系统内公司产品功能示意，其中蓝色为公司模拟和混合信号产品：



公司研发的高性能模拟集成电路与传感器产品线，具备高灵敏度信号感知、精密信号调理、高速数据转换、精准驱动及高效电源管理等全链条技术能力，是构建现代电子系统的基石。公司始终致力于技术创新与产品拓展，持续突破电子技术的性能边界。截止目前，公司拥有 38 大类 6,800 余款可供销售产品，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器、仪表放大器、比较器、SAR 模数转换器（SAR ADC）、 Δ - Σ 模数转换器（ Δ - Σ ADC）、Pipeline 模数转换器（Pipeline ADC）、数模转换器（DAC）、模拟前端（AFE）、音频功率放大器、Audio DAC、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片、EEPROM 以及 DIMM 周边产品等；电源管理类模拟芯片包括 LDO、系统监测电路、DC/DC 降压转换器、DC/DC 升压转换器、DC/DC 升降压转换器、背光及闪光灯 LED 驱动器、AMOLED 电源芯片、PMU、负载开关、过压保护、ESD/TVS、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET 驱动芯片、MOSFET、辅助电源芯片等；传感器包括温度传感器和磁传感器。同时，面向汽车电子领域，公司在信号链、电源管理、传感器等关键领域不断推出通过车规级认证的新产品，赋能智能汽车产业发展。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域，以及电动汽车、数据中心、机器人、可再生能源及新一代消费设备等应用领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（2）公司主要经营模式

1) 盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路及传感器产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合 REACH SVHC 和 RoHS 2.0 绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

2) 研发模式

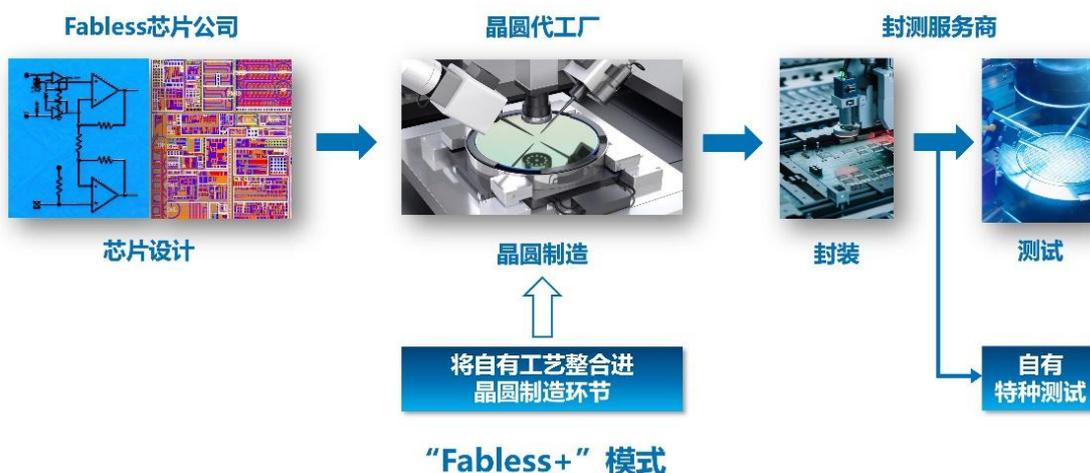
公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同

时针对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内，公司研发人员占公司员工总数的 72.75%，新申请专利 141 项。

3) 生产模式

公司属于无晶圆厂半导体（Fabless）公司，专注于集成电路的研发与销售，将生产环节外包给专业代工厂商，即公司委托晶圆代工厂生产定制化晶圆，并交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。近年来，公司不断拓展专属工艺器件的开发能力，并将自有工艺整合进晶圆制造环节以获得更优的性能和成本；同时，公司也建立起自有特种测试能力，能够自行测试一些具有较高测试要求和难度的产品，实现了对传统 Fabless 模式的拓展，即 Fabless+模式。

公司持续通过严格的评估和考核标准选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台湾积体电路制造股份有限公司。台湾积体电路制造股份有限公司拥有先进的晶圆制造工艺和稳定可靠的产品性能，是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率十几年来一直保持在 50%以上。公司自成立以来便和台积电展开业务合作并保持着良好的合作关系。近年来，公司也针对部分产品工艺需求和国内晶圆代工龙头中芯国际集成电路制造有限公司部分附属公司、韩国的东部高科等晶圆代工厂商开展了晶圆代工合作。报告期内，公司和全球排名前列的封装测试厂商如江苏长电科技股份有限公司及其附属公司、通富微电子股份有限公司及其附属公司、天水华天科技股份有限公司及其附属公司和嘉盛半导体（苏州）有限公司等保持着长期成长、稳定可靠的合作关系。此外，公司还积极加强与供应商的资源整合，不断拓展产能来满足客户需求。报告期内，公司在江苏省江阴市规划建设的集成电路设计测试项目已顺利竣工投产，开始承接部分特种测试业务，公司的常规封测业务仍然以外包模式进行。



4) 销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

(3) 报告期内主要的业绩驱动因素

2025 年，全球宏观经济延续了 2024 年的弱复苏趋势，同时呈现出高分化与结构性驱动的特征。在人工智能、数字化转型和绿色能源三大引擎的共同牵引下，全球经济实现稳步增长，半导体集成电路产业成为关键驱动力之一。这一轮的经济增长不再依赖传统消费电子周期，转而是由 AI 大模型基础设施建设、数据中心规模化扩张及全球供应链区域化重构所主导。半导体集成电路产业的增长动能显著超越宏观经济平均水平，技术需求（尤其 AI 算力需求）与长期结构性趋势构成行业增长的核心驱动力。面对市场环境及行业周期的深刻变革，公司积极应对所面临的挑战，紧密跟踪市场动态

与客户需求，前瞻布局结构性增长热点应用，迅速推出符合市场预期的系列新品，在稳固既有市场和客户根基的同时，大力拓展新客户群体及新兴应用领域，为客户下一代产品的创新开发提供最优的模拟芯片解决方案。

报告期内，公司经营情况稳定，实现营业收入 389,805.46 万元，同比增加 16.46%；实现净利润 53,437.44 万元，同比增加 8.80%，其中，归属于母公司股东的净利润 54,705.94 万元，同比增加 9.36%。

1) 强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，并持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司推出一批具有世界先进水平、满足市场需求的新产品，包括高带宽低噪声运放、高带宽高输出电流运放、高压运放、车规级运放、140dB 对数放大器、高压高精度比较器、超高精度电流检测放大器、120V 16 位精密数字电源监控 AFE、Class-D 音频功放、110dB 32 位 8 通道 Audio DAC、高精度电池监控和保护器、85V 16 位高精度电源监控芯片、内置参考电压及温度传感器的 24 位 ADC、16 通道 24 位 ADC、车规级 24 位低功耗 ADC、高精度低温漂低功耗小尺寸电压基准芯片、LVDS 四通道高速差分线路接收器、车规级高压模拟开关、车规级 36V 多路模拟复用器、车规级 36 通道多路开关、可编程 USB-C 端口控制器、8 通道双向电平转换器、4 位自动检测车规级电平转换器、超微功耗系统定时器、车规级看门狗定时器、紧凑封装小逻辑芯片、车规级小逻辑芯片、5.8GHz WLAN 前端模块、860MHz~930MHz 高功率 RF FEM、2.4GHz TRX FEM、2.4GHz 802.11n WiFi FEM、车规级带可编程看门狗的高精度电压监测芯片、36V 电压检测芯片、低功耗小封装数字温度传感器、低功耗 360 度全向开关 AMR 磁传感器、14 位磁阻 AMR 磁编码器、AMR 角度传感器、超微功耗 Buck 转换器、5.8MHz 1A Buck 转换器、60V 电流模式 Buck 控制器、车规级 100V Buck 控制器、高压大电流 Buck 转换器、低功耗车规级 Buck 转换器、40V/5A 车规级 Buck 转换器、3A Buck 3D 电源模块、9A 低功耗高效 Boost 转换器、25V/20A 同步 Boost 转换器、车规级低功耗 LDO、1A 高精度低噪声车规级 LDO、40V 500mA 低功耗车规级 LDO、2A 高精度低噪声 LDO、10A 4mΩ 负载开关、10 通道负载开关、16V/20A Hot-Swap eFuse、23V/8A eFuse、60V/2A eFuse、带反向电池保护的低功耗理想二极管、车规级理想二极管、30V 功率 MOSFET、60V 功率 NMOS、40V 功率 GaN 晶体管、800mA 三输出 AMOLED 显示屏电源、3.5A 双输出 AMOLED 显示屏电源、1.3A AMOLED 显示屏 PMIC 电源、36 通道 LED 驱动器、高效 40V 可调光 LED 驱动器、高精度 43V 6 通道 WLED 驱动器、RGB LED 驱动器、6 通道 15000:1 大动态调光范围 WLED 驱动器、3 通道车规级 LED 驱动器、辅助电源芯片、1.5A TEC 驱动器、面向备用电源及储能应用的可编程电源管理 IC、高集成度 6 路 PMIC、车规级系统基础芯片（SBC）、高精度锂电池保护芯片、10A 双向开关电容转换器、高压 5A 多节电池充电器、22V/3A 1-4 节电池充电器、车规级多通道高边驱动芯片、车规级 8 通道 38V 低边驱动芯片、35V/2.6A 步进马达驱动芯片、45V/1.5A 步进马达驱动芯片、3.6A 有刷直流电机驱动器、低压双 H 桥芯片、超低电容 ESD 保护器件等近 900 款，广泛覆盖各大产品品类及细分应用领域。

研发人员和研发投入的增加、经验的积累以及技术实力的不断提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，公司每年推出数百款新产品，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩长期稳健成长提供了有力的支撑。

2) 品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、六千余家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在工业与能源、汽车电子、网络与计算、消费类电子等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、机器人等应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

3) 集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2025 年，我国集成电路产业保持了稳步成长，整体规模与全球占比进一步提升、均创历史新高。信息化、智能化浪潮以及包括机器人、人工智能、新能源汽车、绿色能源等新兴产业的进一步快速发展必将推动电子信息产业不断前进，其对集成电路的需求将保持增长态势，全球集成电路产业依然拥有广阔的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末 增减	2023 年末
总资产	6,954,149,664.98	5,771,119,556.50	20.50%	4,706,853,231.69
归属于上市公司股东的净资产	5,294,385,006.97	4,609,226,482.20	14.86%	3,850,547,539.29
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	3,898,054,583.68	3,346,983,120.66	16.46%	2,615,716,404.14
归属于上市公司股东的净利润	547,059,403.97	500,247,943.10	9.36%	280,768,286.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,582,529.58	451,159,069.34	-5.23%	211,774,004.01
经营活动产生的现金流量净额	466,319,946.20	549,337,594.89	-15.11%	170,670,822.08
基本每股收益（元/股）	0.8861	0.8168	8.48%	0.4624
稀释每股收益（元/股）	0.8780	0.8130	8.00%	0.4562
加权平均净资产收益率	11.24%	11.90%	-0.66%	7.63%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	789,561,054.70	1,029,219,240.53	981,827,812.09	1,097,446,476.36
归属于上市公司股东的净利润	59,766,696.38	141,072,452.91	142,395,404.78	203,824,849.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,964,223.73	100,475,303.21	96,650,656.35	196,492,346.29
经营活动产生的现金流量净额	91,705,581.18	148,027,669.90	66,250,176.67	160,336,518.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,473	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况				

				件的股份数量	股份状态	数量
重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司	境内非国有法人	18.94%	117,449,624.00	0.00	不适用	0.00
重庆宝利弘雅企业管理有限公司	境内非国有法人	8.18%	50,712,118.00	0.00	不适用	0.00
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.64%	28,792,495.00	0.00	不适用	0.00
林林	境内自然人	4.29%	26,612,034.00	23,661,372.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.77%	17,182,952.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.64%	16,384,347.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24%	7,720,116.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	7,152,508.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.83%	5,152,044.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	5,026,915.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司、重庆宝利弘雅企业管理有限公司、弘威国际发展有限公司、张勤女士、林林先生为一致行动人。 除上述一致行动人关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

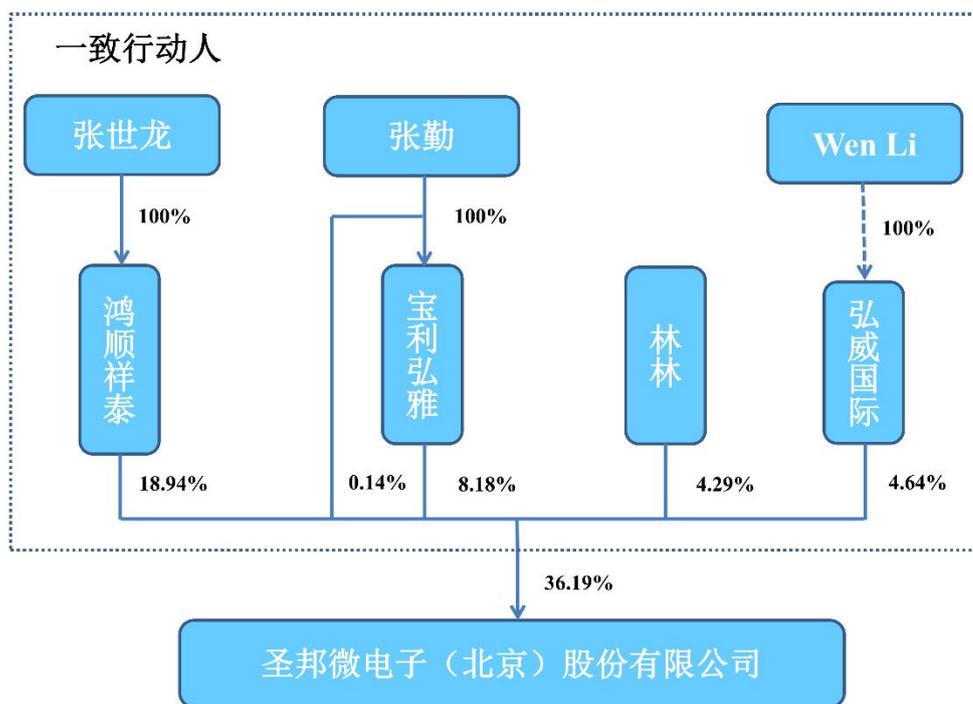
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、实施《2025 年股票期权激励计划》

详细内容请参阅《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”相关阐述。

2、实施 2024 年年度权益分派

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2025 年 6 月 13 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。本次权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、实施《2025 年第二期股票期权激励计划》

详细内容请参阅《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”相关阐述。

4、诉讼事项

截至本报告披露日，公司所涉合同纠纷一案，法院已受理，并根据原告的财产保全申请足额查封冻结公司银行存款人民币 4,400 万元整。该案件已开庭审理，尚无结果。

5、筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的相关议案。公司于 2025 年 9 月 28 日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行 H 股并上市的申请材料，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-097）。

6、关于监事会取消及制度修订情况

公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并对《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》及相关制度进行修订。

7、关于变更会计师事务所

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务及内部控制审计工作。

8、子公司重要事项

2025 年 4 月 8 日，公司披露了《关于全资子公司集成电路设计及测试项目的进展公告》（公告编号：2025-003），圣邦微电子江阴研发生产基地落成，并具备投产条件。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。